

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort: <i>Economic Warfare, Tech Wars und Chip War – Europa zwischen den USA und China</i> .....	V
1. Einleitung .....	1
2. Das „Jahrhundert der Demütigung“ – Narrativ und Kontextualisierung .....	9
3. China unter Xi Jinping – Modernisierungsziele und ideologische Faktoren.....	17
4. Chinas digitale Pläne .....	25
4.1 Made in China 2025 (MIC25) .....	25
4.2 Künstliche Intelligenz (KI) .....	33
4.3 Digital Silk Road (DSR) .....	44
5. Die Beteiligung chinesischer Unternehmen am weltweiten 5G-Ausbau – Eine Möglichkeit zur Auslandseinflussnahme? .....	51
6. Der sino-amerikanische „Chip War“.....	65
6.1 Technologische Hintergründe und Struktur der Chipindustrie.....	65
6.2 Die chinesische Halbleiterindustrie in der Gegenwart – Stagnation trotz umfassender Subventionierung .....	69
6.3 Die US-amerikanischen Halbleiter-Sanktionen gegen China und bisherige Reaktionen der chinesischen Regierung .....	79
6.4 Die Bedeutung der US-amerikanischen Halbleiter-Sanktionen für Chinas digitale Ambitionen und die damit verbundenen Modernisierungsziele Xi Jinpings .....	95
6.5 Potenzielle Gegenmaßnahmen der Volksrepublik China und deren Bewertung.....	99
6.6 Das Risiko einer militärischen Eskalation .....	117
7. Fazit.....	139
Abkürzungsverzeichnis .....	145
Literaturverzeichnis.....	147